



提出期限	第1次受付 2006年5月31日(水)
受付月日	

# 2006実装プロセステクノロジー展 出展申込書

2006実装プロセステクノロジー展の開催・出展規定を了承し、下記の通り申し込みをいたします。

出展内容	小間数	出展内容	小間数
Mタイプ	小間	Sタイプ (2小間まで受け付け)	小間
4、5、6、8、12、14、16小間の希望形態 (AまたはBに印を付けてください)		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B
20小間以上の希望小間寸法		間口	m × 奥行 m

○印をお付けください。	(社)日本ロボット工業会正会員 <input type="checkbox"/>	(社)日本ロボット工業会賛助会員(法人) <input type="checkbox"/>
	日本エレクトロニクスショー協会会員 <input type="checkbox"/>	APEX2006に出展したIPC会員 <input type="checkbox"/>

出展予定製品	日本製品	%	外国製品	% (国名)
--------	------	---	------	--------

主な出展機種 (外国製品等、複数の会社の製品を出展する場合は国名、会社名、機種名を記入してください。)

小間において上記出展機種を下記範囲に分けた場合の占める割合をご記入ください。

電子部品実装機および関連機器・システム	%	実装デバイス包装材	%
実装関連機器・システム	%	実装接合システム	%
半導体実装機・システム	%	高周波対応装置・部品・材料	%
検査・試験装置	%	環境関連装置・材料	%
実装設計システム	%	出版物	%
実装デバイス・部品および関連材料	%	その他	%

他社との共同出展	<input type="checkbox"/> 予定あり (会社名 )	<input type="checkbox"/> 予定なし
----------	--------------------------------------	-------------------------------

事務局  
記入欄

担当者確認

入力日

請求日

小間番号

会社名	フリガナ			社印
	和文			
本社所在地	フリガナ			
	和文			
会社代表者氏名	フリガナ	フリガナ		
		役職名		
出展担当者	フリガナ	フリガナ	電話	( ) -
所属部課	フリガナ	フリガナ	FAX	( ) -
E-mail	フリガナ	インターネット		
		ホームページURL		
所在地	フリガナ	(〒 )		

(注1) 裏面の実装プロセス関連取扱品目にご記入の上、提出してください。  
(注2) 記載事項に変更がある場合は、事務局へその旨書面を提出し、事務局の承認を得てください。



提出期限 第1次受付 2006年5月31日(水)

# 実装プロセス関連取扱品目

自社取扱品目に✓印をご記入ください。

## 電子部品実装機および関連機器・システム

- 電子部品装着機
- 電子部品挿入機
- クリームはんだ印刷機
- はんだ付け装置
  - ディップ槽
  - リフローオーブン
- ディスペンサ
- その他 \_\_\_\_\_

## 実装関連機器・システム

- 搬送システム
- 基板製造機器・システム
- テーピングマシン・材料
- バルクフィーダ・その他フィーダ
- 自動組立装置
- その他 \_\_\_\_\_

## 半導体実装機・システム

- ワイヤーボンダー
- ダイボンダー
- フリップチップ実装システム
- LCD/COGボンディングシステム
- BGA/CSP組立システム
- TAB実装システム
- OLB/ILBシステム
- COBシステム
- その他 \_\_\_\_\_

## 検査・試験装置

- 基板外観検査装置
- 半導体製造関連検査・測定装置
- その他実装関連検査・測定装置
- その他 \_\_\_\_\_

## 実装設計システム

- 設計ツール
- 生産最適化ソフトウェア
- 実装プログラミング装置
- 基板
- その他 \_\_\_\_\_

## 実装デバイス・部品および関連材料

- SMD
- MCM/LSIパッケージ
- 回路形成材料・デバイス
  - チップ部品
  - IC/QFP
  - コネクタ・ソケット
  - スイッチ
  - 封止樹脂
  - 接着剤
- バルク供給部品
- その他 \_\_\_\_\_

## 実装デバイス包装材

- テーピングリール
- キャリアテープ
- TABテープ/リール
- マガジンスティック
- ICトレイ
- バルクケース
- その他 \_\_\_\_\_

## 実装接合システム

- システム
- はんだ付け装置
- はんだ/接合材料
- アンダーフィル材料
- その他 \_\_\_\_\_

## 高周波対応装置・部品・材料

- 装置 \_\_\_\_\_
- 部品 \_\_\_\_\_
- 材料 \_\_\_\_\_
- その他 \_\_\_\_\_

## 環境関連装置・材料

- ゼロミッションプロセス
- 廃棄物処理・回収に関する装置
- 廃棄物処理・回収に関する材料
- その他 \_\_\_\_\_

## 出版物

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## その他

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

会社名	
所属部課	
担当者名	